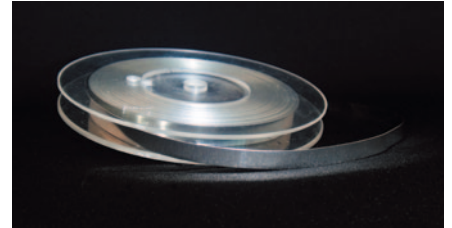


### 水平実装で、高放熱特性を約束

Promise excellent heat dissipation characteristics in horizontal packaging

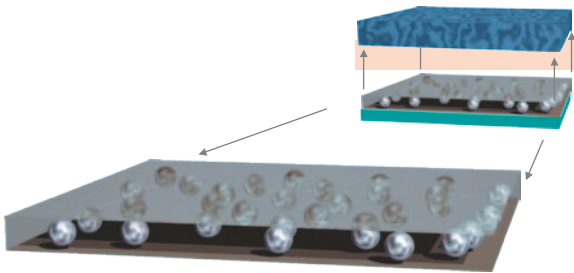
#### 特長

- 傾斜起因のクラックを抑制、高放熱特性を実現
- 一定のはんだ厚確保とボイド低減で、高放熱特性を実現
- 傾斜無きベアチップで、信頼性の高いW/Bを実現

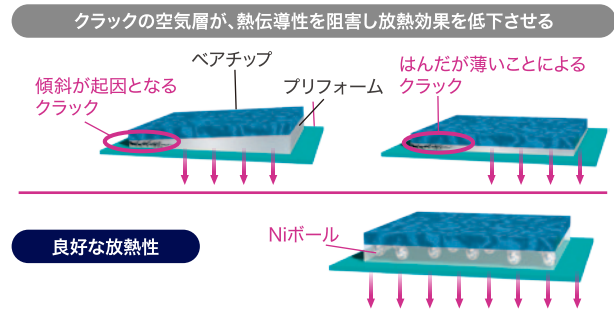


#### 仕様

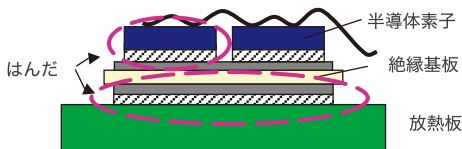
- Niボール含有で、水平実装が可能



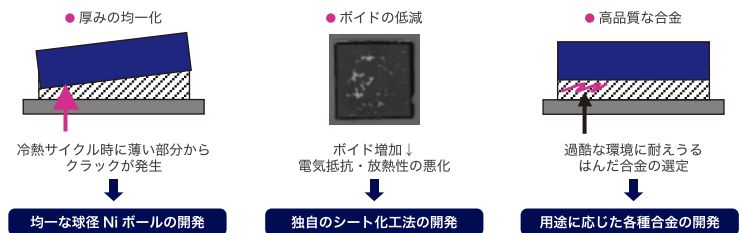
- 高い放熱効果



- パワーデバイス実装の課題解決



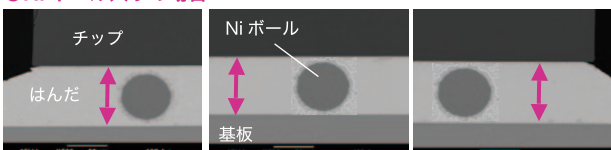
#### パワーデバイス実装の課題解決



- Ni ボール無しの場合



- Ni ボール入りの場合



- 独自工法によるシート化で表面酸化を抑制し、良好なはんだ濡れ性を維持

